

機器利用技術講習会のご案内

【触針式膜厚測定装置】

地方独立法人大阪府立産業技術総合研究所では、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用頂くため、下記の要領で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

◆日 時：平成26年8月27日(水) 14:15~15:30

*当日、「半導体デバイス製造用スパッタ装置(10:15~14:00)」および「超薄膜評価システム(分光エリプソメータ)(15:45~17:00)」の機器利用技術講習会も行っております。当講習会では、これらの機器利用技術講習会で作製した薄膜試料の膜厚を測定します。また、これらの機器利用講習会では、同じ試料に対して光学的手法による膜厚測定も行います。装置の理解をより深めるためにも「半導体デバイス製造用スパッタ装置」および「超薄膜評価システム(分光エリプソメータ)」の機器利用技術講習会を当講習会とあわせて受講されることを強く推奨いたします。

◆場 所：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所(和泉市あゆみ野2-7-1 TEL:0725-51-2518)
当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。

◆定 員：3名(1社1名まで)

※ 受講票は発行いたしません。

※ 受講には TRI カードが必要です。まだお持ちでない方は当日お申し込みいただけます(無料)。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課

※ お申し込みはメール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2509) までお願いします。

メールでお申し込みを頂いた方のみ、返信にて受付をお知らせします。

なお、メールでお申し込みを頂いた方には、当研究所の関連情報をご案内する「産技研ダイレクトメールニュース」を配信させていただきますので、ご了承下さい。

◆対象機器：触針式膜厚測定装置

本装置は、触針(先端半径;2 μ m、先端角;60°)を試料表面に直接接触させ、サンプルステージを走査することで試料表面の凹凸を測定する装置です。

本装置は、走査中に試料にかかる触針の針圧を低加重(最小0.05mgf)に設定できるため、金属膜や無機膜だけでなくレジスト膜や高分子樹脂のような柔らかい表面の凹凸測定が可能となります。また、走査中に針圧が変動しないため、高精度で信頼性のあるデータを得ることができます。

本講習会は、初めて蒸着薄膜膜厚測定を行う方を対象に、機器の概要説明を行なった後、装置付属の標準試料等を用いて、試料のセットアップ方法および測定の実演を行います。



機器型番：P-16+
KLA-Tenchor 株式会社

◆講習担当：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所

制御・電子材料科 寛 芳治、山田 義春、近藤 裕佑

・お問い合わせ先：顧客サービス課 (TEL：0725-51-2518)

